

## ПОВЕДЕНИЕ ЦЕНТРОВ *EL2* В МОНОКРИСТАЛЛАХ ПОЛУИЗОЛИРУЮЩЕГО GaAs ПРИ ТЕРМООБРАБОТКАХ

Картавых А. В., Юрова Е. С., Мильвидский М. Г., Гришина С. П.,  
Ковалчук И. А.

Исследованы закономерности поведения центров *EL2* в монокристаллах полуизолирующего GaAs, выращенных с разным отклонением от стехиометрического состава при термообработке в режимах, близких к постимплантационному отжигу. Обнаружено существенное влияние отклонения от стехиометрии и легирования индием на однородность распределения центров *EL2* в объеме монокристаллов и их термостабильность. Выявлены закономерные изменения концентрации центров *EL2* и повышение однородности их распределения в результате термообработки. Обсуждается природа наблюдаемых явлений.

При формировании активных областей приборных структур методом прямой ионной имплантации важную роль в повышении воспроизводимости характеристик приборов играют однородность исходного монокристаллического полуизолирующего (ПИ) GaAs и термостабильность его электрофизическиских параметров. Термообработка материала в режимах, соответствующих постимплантационному отжигу (850–950 °C и выше), часто приводит к непредсказуемым изменениям его удельного сопротивления и даже типа проводимости [1–8]. В связи с этим принципиальный интерес представляют исследование причин нетермостабильности и выявление возможной связи между условиями выращивания монокристаллов и поведением их свойств при термообработках.

Для выяснения причин нетермостабильности необходимо исследовать поведение при термообработках основных электрически активных центров, обеспечивающих полуизолирующие свойства GaAs, в первую очередь глубокого донора *EL2*, ответственного за компенсацию более мелких остаточных акцепторных центров. Поскольку в образовании *EL2* принимают участие собственные точечные дефекты структуры (СТДС), обусловленные наличием в кристаллах избыточного мышьяка [4], логичной является постановка экспериментов по отжигу монокристаллов, выращенных из расплавов с различным отношением  $[As]/[Ga]$  в исходной загрузке, а также легированных изовалентными примесями, влияющими на состояние и распределение СТДС.

В работе были исследованы нелегированные и легированные индием до концентрации  $(8 \pm 9) \cdot 10^{19}$  ат./см<sup>3</sup> кристаллы ПИ GaAs диаметром ~60 мм, выращенные методом Чохральского из-под слоя флюса из расплавов, состав которых варьировали в пределах  $[As]/([Ga] + [As]) = 0.46 \pm 0.55$ . Плотность дислокаций в нелегированных монокристаллах составляла  $(0.5 \pm 1) \cdot 10^6$  см<sup>-2</sup>, в кристаллах GaAs  $\langle In \rangle = (0.5 \pm 5) \cdot 10^4$  см<sup>-2</sup> и имела характерное *W*-образное распределение. Из верхних частей монокристаллов вырезали поперечные пластины толщиной ~10 мм и производили их оптическую полировку. Регистрацию распределения концентрации центров *EL2* ( $N_{EL2}$ ) проводили сканирующим оптическим методом [6], по поглощению ИК излучения с длиной волны 1 мкм. Сканирование с линейной разрешающей способностью ~500 мкм производилось по диаметру (радиусу) пластины. Для перевода коэффициента поглощения ( $\alpha$ ) в значение  $N_{EL2}$  использовали коэффициент  $1.25 \cdot 10^{16}$  см<sup>-2</sup> [6]. Высокая линейная разре-

щающая способность оптического метода позволила оценить величину  $N_{EL2}$  в локальных объемах материала  $\sim 1 \text{ mm}^3$ .

После измерения исходной  $N_{EL2}$  каждая пластина разрезалась на две толщины  $\sim 5 \text{ mm}$ ; последние подвергались термообработке при  $950^\circ\text{C}$  в течение 2 ч: одна — в протоке водорода, другая — в запаянной кварцевой ампуле в парах мышьяка при давлении 1 атм с последующим медленным (200 К/ч) охлаждением.

С рабочих поверхностей отожженных образцов соплифовывали слой толщиной  $\sim 200 \text{ мкм}$  и после

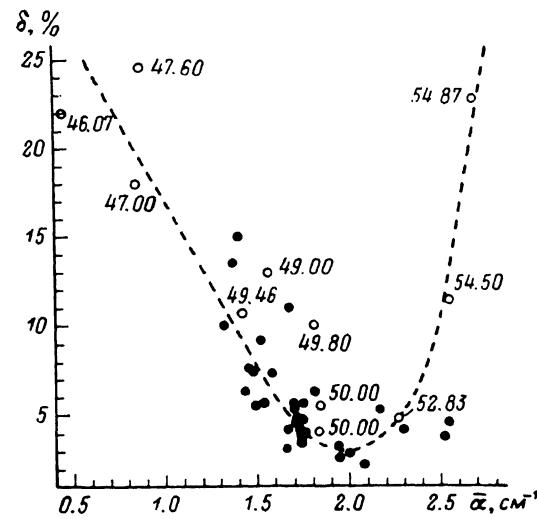


Рис. 1. Зависимость неоднородности распределения  $\alpha_{вх}$  (ОСКО) по диаметру монокристалла от среднего значения  $\alpha_{вх}$  для нелегированного GaAs.

Цифрами дано отношение  $[As]/([Ga]+[As])$  в расплаве для специально выращенных кристаллов.

повторной оптической полировки повторяли измерения  $\alpha$  строго по той же дорожке сканирования.

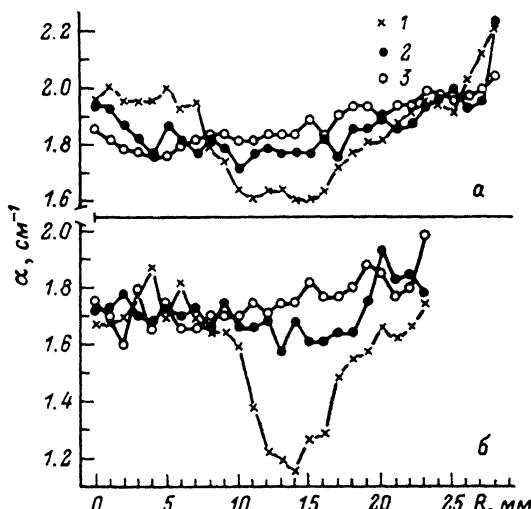
Исследование исходных образцов нелегированного ПИ GaAs показало, что неоднородность распределения  $\alpha$ , оцененная как относительное среднеквадратичное отклонение ( $\delta$ ), усиливается при отклонениях состава расплава от стехиометрического (рис. 1). Средняя величина  $\alpha$  при этом растет с повышением  $[As]$  в расплаве, что позволило построить зависимость  $\bar{\alpha}=f([As]/([Ga]+[As]))$ , практически совпавшую с приведенной в работе [7]. В подавляющем большинстве случаев наблюдался  $W$ -образный характер распределения  $N_{EL2}$  по диаметру кристалла, соответствующий картине распределения плотности дислокаций.

Рис. 2. Регистограммы неоднородности  $\alpha$  по радиусу монокристаллов, выращенных из расплавов различного состава.

$[As]/([Ga]+[As]), \%$ : а — 50.0, б — 49.0.

1 — исходный материал; после отжига: 2 —

в парах мышьяка, 3 — в протоке  $\text{H}_2$ .



При термообработках проявляются три основные особенности поведения центров  $EL2$ : 1) в кристаллах с  $[As]/([Ga]+[As]) \leq 0.5$  среднее значение  $N_{EL2}$  повышается; 2) в кристаллах с  $[As]/([Ga]+[As]) \geq 0.5$  — снижается; 3) неоднородность по  $N_{EL2}$  во всех случаях значительно уменьшается (рис. 2). На рис. 3 точками обозначены величины относительного изменения коэффициента поглощения в локальных ( $\sim 1 \text{ mm}^3$ ) объемах материала в результате термообработки ( $\alpha_{тп}$ ) в зависимости от исходного значения  $\alpha_{вх}$ . Для каждого образца данные получены путем сравнения величин  $\alpha$  до и после отжига в каждой точке регистрации неоднородности. На рис. 3 они сгруппированы с учетом легирования кристаллов и условий их термообработки. Как видно из рисунка, экспери-

ментальные точки, отражающие поведение центра  $EL_2$  в локальных областях кристаллов, выращенных из расплавов различного состава, могут быть описаны при одинаковых условиях термообработки единой кривой. Следовательно, природа отклонений  $\alpha$  от значения, соответствующего стехиометрическому

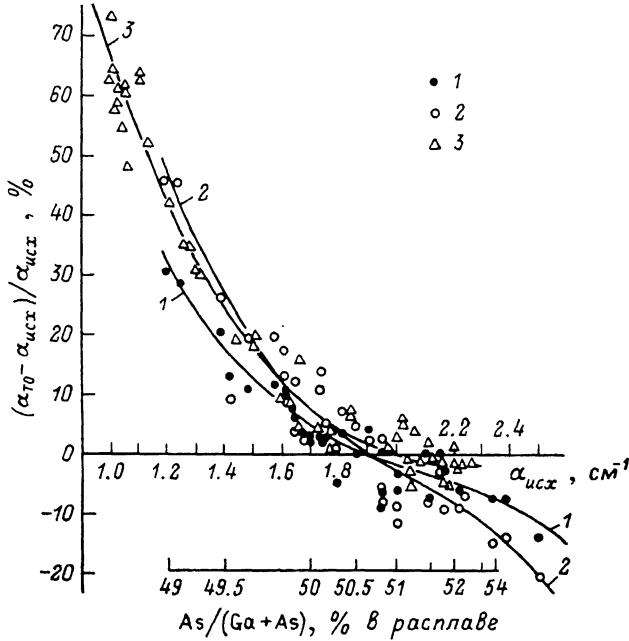


Рис. 3. Зависимость относительного изменения коэффициента поглощения в результате отжига (в %) от исходного  $\alpha$ .

Отжиг нелегированного GaAs: 1 — в парах мышьяка, 2 — в протоке  $H_2$ ; 3 — отжиг GaAs( $In$ ) в протоке  $H_2$ .

составу расплава, одинакова в кристаллах с различными отклонениями от стехиометрии и в локальных областях «стехиометрических» кристаллов. Таким образом,  $W$ -образное распределение  $N_{EL_2}$  обусловлено существованием в сечении даже «стехиометрических» кристаллов областей, обогащенных по Ga и As в пределах области гомогенности GaAs, а закономерности 1—3 отражают один и тот же процесс.

Экспериментальные данные были аппроксимированы степенными многочленами Лагранжа по критерию небольшого ( $\sim 4\%$ ) и приблизительно равного сред-

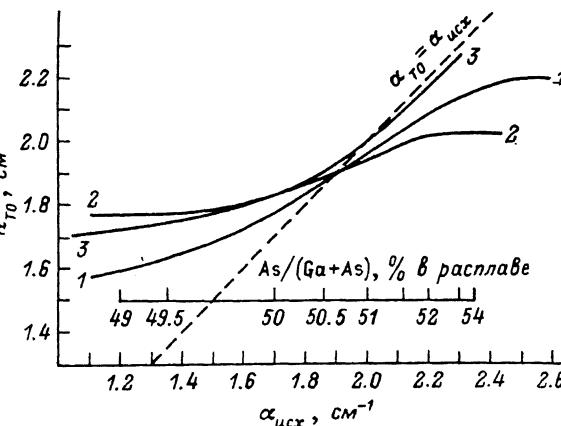


Рис. 4. Усредненные кривые, связанные значения  $\alpha$  до и после отжига, полученные путем обработки данных рис. 3.

неквадратического отклонения точек (рис. 3, кривые 1—3). Эти усредненные кривые были построены в координатах  $\alpha_{ исх }=f(\alpha_{ исх })$  (рис. 4), что позволило выявить ряд дополнительных особенностей. Как следует из рис. 3 и 4, для нелегированного GaAs существует точка «абсолютной» термостабильности, которой соответствует значение  $N_{EL_2} \approx 2.4 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$  ( $\alpha = 1.9 \text{ см}^{-1}$ ), характерное для  $[As]/([Ga] + [As]) \approx 0.507$ . Таким образом, наиболее термостабильными оказываются монокристаллы, выращенные из расплавов с небольшим избытком мышьяка. Как следует из [7], состав таких кристаллов должен быть наиболее

близок к стехиометрическому. В результате изменения концентрации и перераспределения центров  $EL2$  в процессе термообработки происходит выравнивание  $N_{EL2}$  в целом по кристаллу и приближение к уровню  $2.4 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ . С наибольшей скоростью эти процессы протекают в кристаллах нестехиометрического состава, обнаруживающих наихудшую термостабильность. Однако 2-часового отжига оказывается недостаточно для достижения этого «равновесного» значения. Как следует из полученных нами данных, при прочих равных условиях заметное влияние на скорость изменения концентрации и перераспределения центров  $EL2$  оказывают условия отжига: в атмосфере  $\text{H}_2$  процесс протекает эффективнее, чем в атмосфере паров мышьяка (рис. 4).

Единственным, но существенным отличием поведения  $EL2$  в кристаллах, легированных In, является заметное расширение области составов расплава (со стороны избытка мышьяка), из которых удается выращивать термостабильные кристаллы. Как видно из рис. 4, легированный In материал термостабилен при  $N_{EL2} > 2.5 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$  ( $\alpha > 2.0 \text{ см}^{-1}$ ).

Совокупность представленных данных позволяет предположить, что наряду с диффузионным перераспределением СТДС между областями с различной плотностью дислокаций существенную роль в повышении однородности распределения и изменении концентрации центров  $EL2$  при термообработке могут играть процессы распада пересыщенных по собственным компонентам твердых растворов, наблюдаемые в кристаллах при существенном отклонении состава от стехиометрического. При наличии в кристаллах избытка галлия распад сопровождается дополнительной генерацией галлиевых вакансий, а при наличии избытка мышьяка — уменьшением концентрации его межузельных атомов [8]. С учетом того, что в состав центров  $EL2$  входят «антиструктурные» дефекты  $\text{AsGa}$  и (или)  $\text{As}_i$ , величина  $N_{EL2}$  должна в первом случае возрастать, а во втором — падать. Дополнительное введение в GaAs индия, по-видимому, приведет к существенному изменению конфигурации области гомогенности, в первую очередь, со стороны мышьяка, увеличив его растворимость в арсениде галлия при высоких температурах.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Марков А. В., Гришина С. П., Мильвидский М. Г. и др. — ФТН, 1984, т. 18, в. 3, с. 465—470.
- [2] Степанцова И. В., Юрова Е. С., Юрьева И. М. и др. — В кн.: Тез. докл. VII конф. по процессам роста и синтеза полупроводниковых кристаллов и пленок. Новосибирск, 1986, т. 2, с. 187—188.
- [3] Yokogawa M., Nishine S., Matsumoto K. et al. — Inst. Phys. Conf. Ser. N 74, ch. 2, 1985, p. 29—34.
- [4] Holmes D. E., Chen R. T., Elliott K. R. et al. — Appl. Phys. Lett., 1982, v. 40, N 1, p. 46—48.
- [5] Brosel M. R., Grant I., Ware R. M. et al. — Appl. Phys. Lett., 1983, v. 42, N 7, p. 610—612.
- [6] Martin G. M., Jacob G., Poiblaud G. — Inst. Phys. Conf. Ser. N 59, ch. 6, 1981, p. 281—286.
- [7] Katsumata T., Okada H., Obokata T. et al. — J. Appl. Phys., 1987, v. 61, N 4, p. 1469—1474.
- [8] Мильвидский М. Г., Освенский В. Б. Структурные дефекты в монокристаллах полупроводников. М., 1984. 256 с.
- [9] Holmes D. E., Chen R. T. — J. Appl. Phys., 1984, v. 55, N 10, p. 3588—3594.

Государственный научно-исследовательский  
и проектный институт редкометаллической  
промышленности  
Москва

Получена 12.05.1988  
Принята к печати 2.06.1988